

Milano, 27-28 marzo 2025

Congresso su packaging e sostenibilità

In programma a Milano la quinta edizione del congresso scientifico API, Advances in the Packaging Industry, intitolato "Sustainability: Products and Processes".



Si delinea più chiaramente il programma del congresso internazionale API, Advances in the Packaging Industry intitolato "*Sustainability: Products and Processes*", in programma a Milano, presso la Fondazione Cariplo, i prossimi 27 e 28 marzo.

Per parlare di sostenibilità del packaging si daranno appuntamento esponenti del mondo accademico e industriale. Esperti di caratura internazionale interverranno su: eco design, riciclo chimico, materiali biobased e biodegradabili, materiali e imballaggi smart. Si parlerà anche di processi sostenibili nella laminazione, stampa e trasformazione, tecnologie per trattamenti superficiali e rivestimenti, regolamentazione e legislazione, conservazione degli alimenti e valorizzazione dei materiali a fine vita, innovazioni nei materiali da imballaggio a base di cellulosa.

Si tratta della quinta edizione del convegno, dopo quelle tenute a Napoli nel 2015, a Milano nel 2017 e nel 2022, oltre all'incontro virtuale del 2021.

"C'è grande attesa per la quinta edizione di questo imperdibile momento di aggiornamento scientifico - commentano i chairs del congresso Loredana Incarnato (Università di Salerno), Giuseppe Mensitieri (Presidente CRdC, Università di Napoli Federico II) e Alberto Palaveri (Presidente Giflex) -. Abbiamo scelto il titolo Sustainability: Products and Processes perché mai come in questo momento storico l'industria del packaging deve fare i conti con nuovi approcci progettuali che guardino con fiducia al tema della sostenibilità".

"I paper ricevuti sono stati moltissimi dando vita a un programma che fornirà all'intera community una visione multidisciplinare e senza confini sulle principali tendenze dell'innovazione e della ricerca".

Già confermati gli interventi di: Rafael Auras, Amcor Endowed Chair in Packaging Sustainability, School of Packaging, Michigan State University con "Development of Active and Fully Compostable Multilayer Packaging Films"; Stefano Farris, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università di Milano con un intervento su "Coating Technology as a Key Enabling Technology for Sustainable Packaging Solutions"; Patricia Granados, Senior Expert, Footprinting Quantis parlerà di "Leading the change in Flexible Packaging: introducing LCA Guidelines and paving the path forward"; Andrea Lazzeri, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pavia con la relazione "What future for Bioplastic in Europe? Advancing Sustainable Packaging Solutions"; Maria Rosaria Milana, Former Research Director, Istituto Superiore di Sanità (ISS) su "New Trends in Risk Assessment and Safety Regulation on FCM".

Il congresso si terrà in lingua inglese. È organizzato da Università di Salerno e Università degli Studi di Napoli Federico II con la collaborazione di Giflex, Gruppo Imballaggio Flessibile.

Per informazioni e programma: [Congresso API 2025](#)

© Polimerica - Riproduzione riservata